

## CBW-Serie

### Bondbare Chipwiderstände, unmagnetisch

Baugrößen: 0402, 0603, 0805, 1206

#### Merkmale:

- Chipwiderstände in Dickschicht-Technik
- AgPd-Terminierung für Flip Chip Montage (Face-down; für Leitkleber geeignet) oder
- Gold-Terminierung für Drahtbonden (US/TC; Face-up) oder Flip Chip (Face-down; für Leitkleber geeignet)
- Rückseite komplett isoliert
- Kein Umkontakt
- Hochtemperatur-Anwendung bis 200°C ist möglich (CBW-HT)
- Unmagnetisch

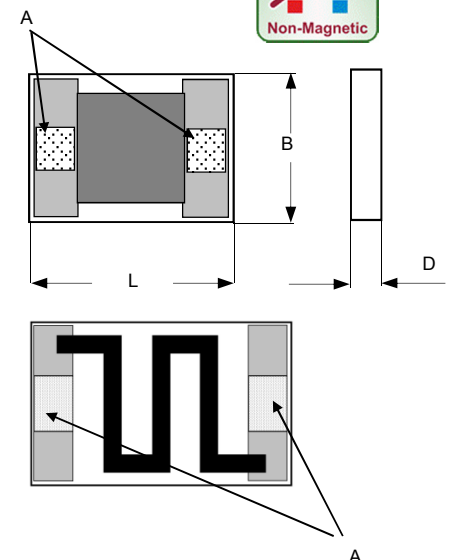


#### Abmessungen:

| Baugröße | L                           | B                           | D                           | A <sub>min</sub> (Bondpad) |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 0402     | 0,95 <sup>+0,10/-0,05</sup> | 0,48 <sup>+0,10/-0,05</sup> | 0,28 <sup>+0,1/-0,05</sup>  | 0,15 x 0,15                |
| 0603     | 1,50 <sup>+0,15/-0,05</sup> | 0,80 <sup>+0,15/-0,05</sup> | 0,40 <sup>+0,15/-0,05</sup> | 0,20 x 0,20                |
| 0805     | 2,00 <sup>+0,15/-0,05</sup> | 1,25 <sup>+0,15/-0,05</sup> | 0,40 <sup>+0,15/-0,05</sup> | 0,25 x 0,40                |
| 1206     | 3,20 <sup>+0,15/-0,05</sup> | 1,50 <sup>+0,2/-0,05</sup>  | 0,40 <sup>+0,15/-0,05</sup> | 0,30 x 0,50                |

L = Länge, B = Breite, D = Dicke, A = Bondpad (in mm)

Andere Baugrößen und Layouts sind auf Anfrage auch möglich.



#### Lieferformen:

Schüttgut in Plastikbeuteln – ab 100 Stück/Wert

Waffle-Pack / GelTray (2") – ab 100 Stück/Wert

Im Blistergurt nach IEC 60286-3 – ab 500 Stück/Wert (0402 ab 1000 Stück)

Spulendurchmesser 180 mm oder 330 mm

- Lage im Gurt:
- ♦ Face-up für Drahtbond-Anwendung
  - ♦ Face-down für Flip-Chip-Anwendung

Die Lage im Gurt ist bei der Bestellung festzulegen.

#### Bestellangaben:

Gold-Terminierung für Face-up Montage (Bonden)

Typ – Wert – Toleranz – TK - Terminierung

Beispiel: CBW 0603 100K ±5% TK100 Au

AgPd-Terminierung für Face-down Montage (Flip Chip)

Typ – Wert – Toleranz – TK

Beispiel: CBW 0603 1G ±20% TK1000

Falls keine Angaben zu TK und Verpackung vorliegen, werden die Standardwerte (größter TK Wert) angenommen und Schüttgut geliefert. Ohne Spezifikation wird Face-up gegurtet und als Terminierung AgPd für Flip-Chip-Anwendung eingesetzt. Die Standard-Meßspannung ist 10V, abweichende Spannungen sind explizit anzugeben und zu vereinbaren.

Änderungen vorbehalten

Made in Germany

Ausgabe 10-2015

**SIEGERT TFT GMBH**  
 Robert-Friese-Straße 3  
 07629 Hermsdorf



Fon: +49 (0)36601 / 8580  
 Fax: +49 (0)36601 / 85811  
 E-mail: info@siegert-tft.de  
 Internet: www.siegert-tft.de.de

# CBW-Serie

## Bondbare Chipwiderstände, unmagnetisch

Baugrößen: 0402, 0603, 0805, 1206

### Technische Daten - baugrößenabhängig:

| Baugröße   | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 |
|--|------|------|------|------|
| Belastbarkeit P <sub>70</sub> (mW)<br>(P <sub>155</sub> = 0 mW)          | 50   | 100  | 125  | 250  |
| Max. Nennspannung <sup>3)</sup><br>U <sub>-</sub> , U <sub>eff</sub> (V) | 60   | 150  | 200  | 400  |

| Wertebereich /<br>Toleranz / TK <sup>1)</sup> / VCR <sup>2)</sup> |  |  |  |                                      |
|---|--|--|--|--------------------------------------|
| 10R – 10M   | 5/10/20%<br>TK100/250                  | 5/10/20%<br>TK50/100                   | 5/10/20%<br>TK50/100                   | 5/10/20%<br>TK50/100                 |
| >10M – 100M   | 5/10/20%<br>TK100/250<br>500 ppm/V     | 5/10/20%<br>TK50/100<br>500 ppm/V      | 5/10/20%<br>TK50/100<br>500 ppm/V      | 5/10/20%<br>TK50/100<br>250 ppm/V    |
| >100M – 1G  | 10/20/30%<br>TK500<br>1000 ppm/V       | 5/10/20%<br>TK250/500<br>500 ppm/V     | 5/10/20%<br>TK250/500<br>500 ppm/V     | 5/10/20%<br>TK100/250<br>250 ppm/V   |
| >1G – 10G   | 10/20/30%<br>TK2000<br>2000 ppm/V      | 5/10/20%<br>TK500/1000<br>1000 ppm/V   | 5/10/20%<br>TK500/1000<br>1000 ppm/V   | 5/10/20%<br>TK250/500<br>500 ppm/V   |
| >10G – 100G   | 10/20/30%<br>TK2000/3000<br>5000 ppm/V | 10/20/30%<br>TK2000/3000<br>3000 ppm/V | 10/20/30%<br>TK2000/3000<br>3000 ppm/V | 5/10/20%<br>TK500/1000<br>1000 ppm/V |
| >100G – 1T  | <i>auf Anfrage</i>                     | <i>auf Anfrage</i>                     | 10/20/30%<br>TK3000<br>5000 ppm/V      | 10/20/30%<br>TK2000<br>2000 ppm/V    |

<sup>1)</sup> TK: in ppm/K; Temperaturbereich +25°C...+125°, bei TK kleiner als Standard (größter Wert) oder R >100G: +25°C...+85°C

<sup>2)</sup> VCR: typische Werte, alle Werte negativ, nicht für alle TK-Werte möglich

<sup>3)</sup> Max. Dauerbetriebsspannung (U<sub>-</sub>, U<sub>eff</sub>):  $U \leq \sqrt{P \cdot R}$  bzw. max. Nennspannung  
Andere Werte von Toleranz, TK und VCR nur auf Anfrage und Vereinbarung

### Technische Daten - allgemein:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Arbeitstemperaturbereich           | -55°C ... +155°C |
| Klimakategorie nach DIN EN 60068-1 | 55/155/56        |

Erweiterter Einsatztemperaturbereich bis 200°C: siehe Datenblatt „Hochtemperatur-Chipwiderstände“ CBW-HT

| Langzeitstabilität              | < 10M   | 10M - 1G | 1G - 10G | ≥10G |
|---------------------------------|---------|----------|----------|------|
| Lagerung 125°C/1000h            | < 0,5%  | <1%      | <2%      | <5%  |
| Maximale Spannung/1000h         | < 0,5%  | <0,5%    | <1%      | <2%  |
| Kurzzeitüberlast (2,5-fach, 5s) | < 0,25% |          |          |      |

Daten, soweit nicht spezifiziert, nach EN 140401-802 (CECC 40401-802).